

华润微电子有限公司

投资者关系活动记录表

(2025 年 4 月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）		
参与单位名称	4 月 30 日 10:00-11:00 国信证券 华泰证券 瑞银证券 招商证券 开源证券 国盛证券 华金证券 国元证券 兴业证券 中原证券 吕梁小金地 兴业银行 循远资产 深圳市尚诚资产 上海明沚投资 北京中泽控股 上海瀚伦私募 东北证券 国海证券 华安证券 平安证券 美银证券 国投证券 国金证券 西部证券 财通证券 中信建投证券 宁波明盛资产 中国国际金融 复通私募 星展唯高达香港 花旗环球金融 江苏天骏投资 毕盛(上海)投资 华福证券 华源证券 东方证券 摩根大通证券 东方财富证券 浦银国际证券 摩根士丹利证券 国泰海通证券 上海申银万国证券 湘财证券 华泰资产 易方达基金 深圳市中金岭南资本 鲍尔赛嘉投资 长江证券资产 温州启元资产 英大基金		

	赢舟资产 鸿运私募 嘉合基金 朗辉信泽投资 上海熵盈私募 深圳市兴亿投资 磐厚动量资本 泰山财产保险 深圳长青藤资产 粤佛私募基金 胡杨私募 北京星允投资 柏基投资(上海) 山东嘉信私募 远致瑞信投资 苏州和基投资 国联民生证券 中信期货	湖南潇湘资本 长信基金 创金合信基金 高盛(亚洲) 杭州量界投资 上海聆泽投资 西藏信托 长城财富保险资产 耕霖(上海)投资 新华资产 红土创新基金 上海匀升投资 深圳市唯德投资 北京紫薇私募 上海益和源资产 北京盛曦投资 国任财产保险 建信金融资产	北京鑫翰资本 上海润桂投资 西部利得基金 上海伯兄资产 江苏瑞华投资 上海高毅资产 东兴基金 融通基金 信达证券 上海嘉世私募 青岛城投城金控股 上海标朴投资 瑞锐海外投资 Nas Tyx Cap Morgan Stanley UBS Group XL Equities Point 72
时间	4 月 30 日 10:00-11:00		
地点	无锡（电话会议）		
上市公司接待人员 姓名	何小龙 华润微电子董事长 吴国屹 华润微电子董事、财务总监兼董秘		
投资者关系活动 主要内容介绍	一、董事长致辞 我是华润微新任董事长何小龙，我谨代表公司管理层做2024 年年报暨 2025 年一季报解读。今天，我有三个“新”想与各位分享： 第一是“新突破”。2024 年公司全年营业收入突破百亿大关达 101.19 亿元，归母净利润 7.62 亿元，其中第四季度净利润环比增长 26.28%，盈利能力持续改善；同时，2025 年一季度营		

	收也呈现上扬态势。业绩背后，是我们在功率半导体、数模混合、智能传感器及智能控制等多航道精准发力的体现。 第二是“新动能”。我们始终将研发创新视为公司生命线，全年研发投入达 11.67 亿元再创新高，占营收比重达 11.53%，研发投入实现自上市以来连续五年正增长。值得一提的是，公司依托“两江三地”布局，高效高质推动重庆 12 吋晶圆制造生产线、深圳 12 吋集成电路生产线、重庆先进封测基地、高端掩模等重点项目。 第三是“新起点”。面对 AI 技术革命带来的产业重构机遇，公司将持续发挥 IDM 商业模式和功率器件产品组合优势，加快 SiC 和 GaN 技术平台迭代和系列化，为汽车电子、数据中心、充电桩、光储逆变、高端消费等核心客户提供产品组合。与此同时，重点聚焦高端传感器领域的 MEMS 技术开发和性能迭代。 作为新任董事长，我深知半导体产业既是国之重器，也是长久事业。未来，我将与全体华润微电子人一道，坚持技术创新，坚持战略定力，坚持股东价值优先。我们期待与各位投资者建立更紧密的沟通机制，定期举行交流活动，让创新成果看得见、摸得着。 二、投资者的主要问题 问题一：终端领域，下游汽车、工业、消费等景气度情况？ 答：汽车电子领域，随着电动化、智能化、网联化技术的推动，汽车芯片用量及价值日益提升，同时，车规级半导体国产化率偏低，是公司重点发力及高增长的领域。消费电子领域，二季度作为传统旺季产销规模保持稳定增长。新能源领域，光伏储能二季度接单量明显增长。工控领域，细分领域较多，整体需求平稳。
--	--

	问题二：请问公司重点产品 MOSFET、IGBT 今年预期增长？ 答：公司 MOSFET 产品整体市场规模保持稳定增长，公司凭借 6、8、12 吋产能优势，以及在品类、性能、成本的竞争优势，今年预期实现 15%左右的增长。IGBT 产品在工控、汽车、消费领域订单均有同比大幅提升，同时加快产品结构升级，在 8 吋、12 吋产线加快上量，今年预期实现 50%左右的增长。 问题三：请问公司 2025 年一季度毛利率变动的原因？ 答：公司一季度毛利率为 25.29%，同比减少了 1.1 个百分点。从结构来看，毛利率的下降主要原因是高端掩模工厂投产导致每月折旧明显增加，叠加 IC 类产品价格下降。但是，功率器件及封装测试业务毛利率均好于同期。 问题四：请问公司模拟及 MEMS 产品需求是否有明显变化？ 答：公司模拟类产品受益于消费领域传统旺季叠加国补等影响，接单情况良好，特别是 6 吋已出现产能短缺情况。MEMS 产品尤其是喷墨打印头，因公司布局较早且工艺处于国内领先水平，订单情况明显好转。 问题五：请问公司今年资本开支规划？ 答：2025 年资本开支预计 20 亿元，其中设备开支 19 亿，主要为封测基地产能爬坡，以及填平补齐的设备投资等。股权投资具有不确定性，不计入其中。 问题六：请问公司针对不同下游的销售策略有何区别？ 答：产品方面会采取差异化策略。消费领域以降本增效为目标，积极推进性价比更高的产品，拓展产品形态创新，推进小型化、全集成化，提升市占率。汽车、工控等领域以提高产品可靠性
--	---

为目标，提升工艺和质量，降低损耗。

问题七：请问公司两条 12 吋线进展情况？

答：重庆 12 吋产线，产能利用率目前在 70%左右，力争年底实现满产，今年将围绕汽车、高端工控及算力市场等重点领域进行突破。深圳 12 吋产线，明后两年均处于产能爬坡上量阶段，目前 90nm 平台多颗产品导入上量，55/40nm 产品成功导入与平台同步验证，产品涵盖高性能电源和 MCU 等高端特色工艺产品门类及显示驱动、蓝牙等产品门类。

问题八：请问公司 2024 年和一季度下游新能源、消费电子、工业和通信各占比？

答：从产品与方案板块来看，2024 年度及 2025 年一季度细分市场占比情况基本趋同，占比分别为汽车电子占比 21%，新能源占比 20%，家电占比 18%，工业设备占比 16%，通讯设备占比 9%，计算机 5%，照明 4%，智能穿戴、医疗及其他占比 7%。

问题九：碳化硅等新产品的进展？

答：公司碳化硅产品系列不断丰富，全面覆盖 650V、1200V、1700V 电压平台，同时不断优化产品结构，SiC MOS 占比超过 50%。车规级 SiC MOS 和 SiC 模块在车企推进测试中。产品工艺方面，SiC MOS G2 和 SiC JBS G3 均已完成产品系列化，其中 SiC MOS G2 Rsp 水平达到国际主流产品水平，SiC JBS G3 功率密度水平达到国际领先，得到客户的高度认可。

问题十：功率半导体行业的景气度，产品价格变化趋势？

答：整体来看行业呈现温和复苏趋势，已出现量增价稳格局，公司认为今年产品价格将稳定在一定区间内。

附件清单（如有）	无
日期	2025 年 4 月